

第101回レーザー加工学会 講演会 (予告プログラム)

1日目 2024年12月3日(火)

第一会場 (多目的ホール)			
9:55	開会の辞	大家利彦 (奈良先端科学技術大学院大学 レーザ加工学会会長)	
10:00	ポスターショートプレゼンテーション(各2分間) + ポスタープレゼンテーション	司会: 山崎洋輔 (カナデビア(株))	
	ポスター講演	テーブルトップ展示	カタログ展示
	レーザーメタルデポジションによる超硬合金部材の補修に関する基礎検討	山口拓人 (大阪産業技術研究所)	(株)プロフィット ブネウム(株)
	近接場光を用いた高減衰・偏光無依存ビームサンプリング技術	徳田将志 (産業技術総合研究所)	レーザーライン(株)
	青色半導体レーザーマルチビーム金属堆積法を用いた純銅コーティングによる抗菌作用の発現	吉田環 (大阪大学)	IPGフォトニクスジャパン(株)
	16kWディスクレーザを用いた鋼板のキーホール溶接における溶融・凝固挙動の解析	池上優希 (大阪大学)	(株)タムロン
			夏目光学(株)
			ブネウム(株)
			インテック(株)
			バルステック工業(株)
第一会場			
3A1	ベストオナー賞受賞講演	司会: 村田隆行 (川崎重工業(株))	
11:30	ベイズ最適化によるき裂生成を抑制したレーザー積層造形傾斜組成超硬合金層の組成導出	山下順広 (石川工業高等専門学校, 現: 福井大学)	
12:00	カーボンニュートラルに貢献する表面改質へのレーザー応用	横田博紀 (トーカロ(株))	
昼食休憩 (12:30~13:30)			
第一会場 (多目的ホール)			
3A2	近畿高エネルギー加工技術研究所 見学	司会: 村田隆行 (川崎重工業(株))	
13:30	近畿高エネルギー加工技術研究所のご紹介	清水英樹 (近畿高エネルギー加工技術研究所)	
14:00	近畿高エネルギー加工技術研究所 設備見学	・グループ分けをして各グループ 2設備程度の見学となります。1グループの見学時間は30~40分程度となりますので、その他の時間は企業展示見学やご休憩にお当てください	
Coffee break (16:00~16:30)			
第一会場 (多目的ホール)		第二会場 (会議室1, 2, 3)	
3A3	レーザー加工装置	3B1	超短パルスレーザー加工1
司会: 山崎洋輔 (カナデビア(株))		司会: 栗田典夫 (浜松ホトニクス(株))	
16:30	ハイパワーCWレーザーによる高速高精度切断技術の確立に向けて	16:30	超短パルスレーザー駆動バブルを用いた広域材料対応型マイクロ描画プロセス
	松尾一輝 ((株)EX-Fusion)		西山宏昭 (山形大学)
17:00	超高速スキヤニングシステムの紹介と加工事例	17:00	ピコ秒パルスレーザー多点集光によるガラスの微細溶接
	大串修己 (川崎重工業(株))		岡本康寛 (岡山大学)
17:30	終了		
17:30~18:00 休憩 移動			
懇親会 小ホール(18:00~20:00)			

第101回レーザー加工学会講演会 (予告プログラム)

2日目 2024年12月4日(水)

第一会場 (多目的ホール)		第二会場 (会議室1, 2, 3)	
プレナリーセッション		司会: 村田隆行 (川崎重工業(株))	
10:00	【基調講演】レーザー粉末床溶融法による形状・材質制御と医療デバイスへの応用	中野貴由 (大阪大学)	
10:40	【基調講演】ファイバーレーザーのコヒーレントビーム結合	白川晃 (電気通信大学)	
昼食休憩 (11:20~12:30)			
第一会場 (多目的ホール)		第二会場 (会議室1, 2, 3)	
4A1	レーザービーム制御 司会: 三瓶和久 ((株)タマリ工業)	4B1	超短パルスレーザー加工2 司会: 岡本康寛 (岡山大学)
12:30	光技術による様々なレーザー加工への効果 舟木厚司 ((株)アマダ)	12:30	液相フェムト秒光渦アブレーションによる非対称マイクロ構造体創成 川口 晴生 (核融合科学研究所)
13:00	アルミニウムの新時代 ①アルミニウムとレーザー溶接 大脇桂 (一般社団法人 とやま接合技術推進協会)	13:00	空間位相・偏光制御ビームを用いた金属・半導体の微細加工 中村大輔 (九州大学)
13:30	アルミニウムの新時代 ②最先端レーザー溶接技術が実現する高品質・低ひずみ加工 大脇桂 (一般社団法人 とやま接合技術推進協会)	13:30	GHz/バーストモード加工 櫻井治之 (東京大学)
14:00	狭線幅青色レーザーと波長合成技術を用いた1.7kW高輝度高出力加工用光源の実現 島山和也 (日亜化学工業(株))	14:00	空間光位相制御技術のレーザー加工への応用展開 伊藤晴康 (浜松ホトニクス(株))
Coffee break (14:30~15:00)			
第一会場 (多目的ホール)		第二会場 (会議室1, 2, 3)	
4A2	アディティブマニュファクチャリング 司会: 中村暁史 (パナソニック(株))	4B2	微細加工システム 司会: 栗田典夫 ((株)浜松ホトニクス(株))
15:00	ワイヤ・レーザー金属3Dプリンタの最新造形事例 森田大嗣 (三菱電機(株))	15:00	微細加工用レーザー加工機/光学エンジン要素技術の紹介 奥山大輔 ((株)レーザーシステム)
15:30	レーザーを使用したAMIは製品加工機となれるのか 澤越俊幸 (一般社団法人日本AM協会)	15:30	加工軌跡に応じて偏光方向を制御したレーザー四角穴加工 加藤悦史 ((株)片岡製作所)
16:00	DOEビームプロファイル制御技術を活用したレーザークラディング技術の開発 林良彦 (大阪富士工業(株))	16:00	超短パルスレーザーによる微細加工技術や事例 大竹俊介 ((株)リブスワークス)
16:30	レーザークラディングによる新規鉛フリー銅合金の創製および摺動特性の評価 渡邊健太郎 (川崎重工業(株))		
17:00	終了	16:30	終了

時間、内容に一部変更が生じる場合がありますのでご了承下さい。